

LCP 日本宝理 S471-BK010P连接器专用LCP塑胶原料详情

产品名称	LCP 日本宝理 S471-BK010P连接器专用LCP塑胶原料详情
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

POM的加工温度范围很窄（195-215℃），在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃就会分解（均聚物材料为190~230℃；共聚物材料为190~210℃）。螺杆转速不能过高，残量要少。

在制作连接器产品的时候，总会有需要用到塑料材质的时候，连接器将介绍连接器生产时常用的塑料材质有哪些？这些材质又需要满足汽车连接器产品的哪些要求呢？就制作材质来说，连接器常用到的塑料原材料主要有PBT、66、6T、9T、LCP等，而这些材料在质量、耐高温性能以及价格上都是有区别的，当然了，这些区别也会体现在连接器价格之上。

具有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。

POM具有明显的熔点，均聚POM为175℃、共聚POM为165℃。成型时，料筒温度的分布：前段190~200℃，中段180~190℃，后段150~180℃，喷嘴温度为170~180℃。对于薄壁制品，料筒温度可适当提高些，但不能超过210℃。

塑胶对电、热、声具有良好的绝缘性:电绝缘性，耐电弧性，保温，隔声，吸音，吸振，消声性能卓越。

它是一种新型的高分子材料，在熔融态时一般呈现液晶性。这类材料具有优异的耐热性能和成型加工性能。

POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160℃，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10℃以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10℃左右。可在-40℃~100℃温度范围内长期使用。

塑胶原料大部分可循环使用,但由于翻用塑料(水口料)比一般原料要脆,所以只可混合新料(原料)一起使用,比例最大不可超过25%为合适,应以顾客要求标准为原则.各种类型的塑料料因所需的熔点不同,所受的注塑压力不同,生产中一定不可相混淆.

热塑性塑料(Thermo plastics)：指加热后会熔化，可流动至模具冷却后成型，再加热后又会熔化的塑料，即可运用加热及冷却，使其产生[可逆变化](液态 固态)，是所谓的物理变化。

通用塑料这类塑料时一类用途十分广泛的塑料，它产量大，约占塑料总产量的四分之三，价格低，大量用来制作受力不大的日用品，如电视机外壳、电话机外壳、塑料盆、塑料桶等。与人们的关系十分密切，成为塑料工业的重要支柱。常用的通用塑料有PE、PVC、PS、PP、PF、UF、MF等。

减震效果好多数塑胶原料富有粘弹性，当它受到机械振动时，塑胶原料内部会产生粘弹内耗，将机械能转变为热能，从而削弱了震动，因此塑料可制作减震消声制品。

聚合物:指聚合过程所产生的纯材料或称聚合材料。无论天然树脂还是合成树脂均属高分子合聚物，简称高聚物。

减摩、耐磨性能好大多数塑胶原料具有优良的减摩、耐磨和自润滑性能，它们既可以在水、腐蚀介质中正常工作，也可在边界摩擦和干摩擦条件下有效地工作，比金属要低很多，只有金属要好得多，通常塑胶原料的摩擦系数，比金属要低得多，只有金属的几分之一到十几分之一，因此可用塑胶原料制作许多减摩和耐磨制品。

LCP塑胶原料可以加入高填充剂作为集成电路封装材料，以代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料等。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316 左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。